

第三届智能材料与结构工程国际学术会议

(ICSMSE 2019)

会议时间: 2019年7月26-28日

截稿日期: 见会议官网

地点: 中国·桂林

官网: www.keoaeic.org/ICSMSE2019

会议简介

第三届智能材料与结构工程国际学术会议(ICSMSE 2019)由AEIC学术交流中心主办,将于2018年7月26-28日在中国桂林隆重举行。会议主要围绕智能材料与结构工程等研究领域展开讨论。会议旨在为从事智能材料与结构工程研究的专家学者、工程技术人员、技术研发人员提供一个共享科研成果和前沿技术,了解学术发展趋势,拓宽研究思路,加强学术研究和探讨,促进学术成果产业化合作的平台。大会诚邀国内外高校、科研机构专家、学者,企业界人士及其他相关人员参会交流。

征 稿 通 知

出版检索

IOP Conference Series
Proceedings services for science

ICSMSE 2019所有的投稿都必须经过2-3位组委会专家审稿,经过严格的审稿之后,最终所有录用的论文将被EI目录期刊**IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE)**(ISSN: 1757-8981)出版,并且被**EI, CPCI, Scopus**检索。目前该期刊EI检索非常稳定!

征稿主题

- ☑ 智能材料
- ☑ 建筑结构
- ☑ 地质工程
- ☑ 城市工程
- ☑ 更多征稿主题, 请查看官网

类别	注册费 (人民币)
第一篇投稿 (4-6页)	2800元/篇
第二篇投稿 (4-6页)	2600元/篇
超页费 (第7页起算)	300元/页
仅参会不投稿	1200元/页
★仅参会不投稿 (团队)	1000元/团队参会3人以上
额外加购论文集	500元/本

会议议程

7月26日

13:00-17:00 报到注册

7月27日

09:00-12:00 邀请报告

12:00-14:00 午餐

14:00-17:30 口头报告

18:00-19:30 晚宴

7月28日

09:00-18:00 学术考察

联系人：彦老师

会议网站：www.keoaeic.org/ICSMSE2019

投稿邮箱：ICSMSE@163.com

通讯电话：+86-13798148224

QQ：3326203643 理工科QQ群：815234922

WeChat：13798148224

AEIC官网：www.keoaeic.org



关注AEIC微信公众号

第三届智能材料与结构工程国际学术会议

2019年3月4日

